

[반도체]

도현우
 02-3774-3803
 hwdoh@miraesasset.com

홍솔
 02-3774-1851
 sol.hong@miraesasset.com

반도체

장비 시장 성장 지속

ASML이 양호한 실적을 발표

반도체 노광 장비 1위 회사 ASML이 양호한 1Q17 실적을 발표했다. 매출액 € 1.9bn(+2% QoQ +46% YoY), 영업이익 €535bn(+1% QoQ, +135% YoY)을 기록했다. 가이던스를 상회했다. 2Q17 매출액 가이던스는 €1.9~2.0bn이다. 수주 잔고는 전 분기 €4.0bn에서 €4.5bn으로 증가했다. 1Q 실적 내용 중 중국의 지역별 매출 비중이 전 분기 3%에서 26%으로 크게 증가한 것이 특이했다. 메모리 장비 비중은 40%에서 47%로 증가했다. DRAM 1xnm 비중 증가와 3D NAND 캐파 증가가 이유다.

1Q17 증가한 주문량 중 메모리 비중이 컸다. 회사는 메모리 장비 주문 증가는 향후 몇 분기 지속될 것이라고도 했다. 특히 **DRAM 장비 주문이 증가할 가능성이 높다고 했다.** 과거 경험상 투자 축소로 인한 DRAM 가격 상승은 향후 항상 장비 발주 증가로 이어졌다고 설명했다. DRAM 장비는 2016년 낮은 주문이 2017년 크게 보완될 것이라고 전망했다.

EUV 장비 양산 투입 시작

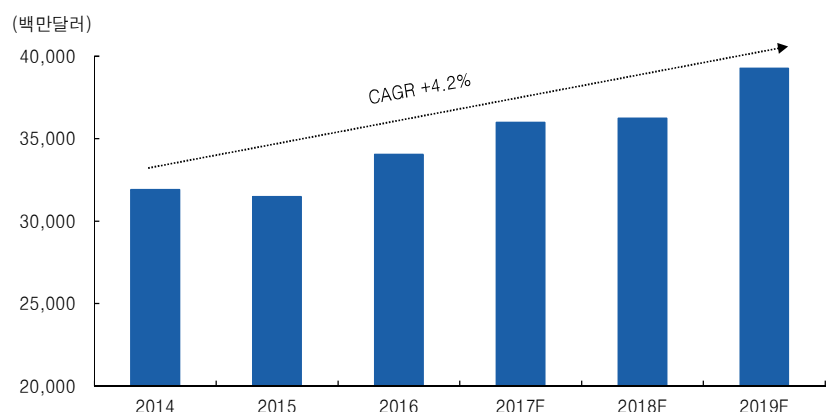
컨퍼런스 콜에서 투자자들의 질문은 차세대 노광 장비 EUV에 집중되었다. 우선 1Q17 3대의 EUV 장비 주문이 이루어졌다. EUV 장비 수주 잔고는 21대로 늘었다. 최신 EUV 장비 NXE:3400B의 웨이퍼 출하량은 시간 당 125장을 넘어섰고 13nm 선 폭을 1회의 패터닝으로 구현할 수 있다. 회사는 2017년 EUV 장비 매출이 €1.0~1.2bn에 달할 것으로 예상했다. EUV 장비 매출이 본격화되고 있다. 회사는 EUV 장비가 7nm 로직 반도체와 16nm DRAM에서 본격 사용되기 시작할 것으로 이야기했다. **DRAM에서는 2019년 16nm 공정의 1~2개 레이어부터 EUV가 사용될 것으로 전망했다.**

중국의 반도체 시장 진입

컨퍼런스 콜에서 중국의 반도체 시장 진입에 대한 내용도 많았다. 회사는 향후 12개월 내 중국 메모리 반도체 업체들의 기술 선택과 웨이퍼 장비 선정 등이 상당 부분 이루어질 것이라고 했다. 2018년은 시험 생산이 시작되고 2019년부터 양산이 가속화된다고 했다. 기존 노광 장비인 DUV는 2018년부터 기존 고객들의 비중이 줄어들고 중국 고객들의 비중이 늘면서 성장세가 지속될 것이라고 전망했다.

위의 내용들을 종합했을 때 우리가 업황에 대해 전망할 수 있는 점은 다음과 같다. 1) 반도체 장비 시장 성장세가 지속될 것이다. 2) 특히 2017년 하반기는 DRAM 투자가 늘어날 것이다. 3) 많은 논란에도 불구하고 EUV 장비 양산 투입이 빨라질 것이다.

반도체 장비 시장 전망



자료: Gartner, 미래에셋대우 리서치센터

ASML 실적 발표 데이터

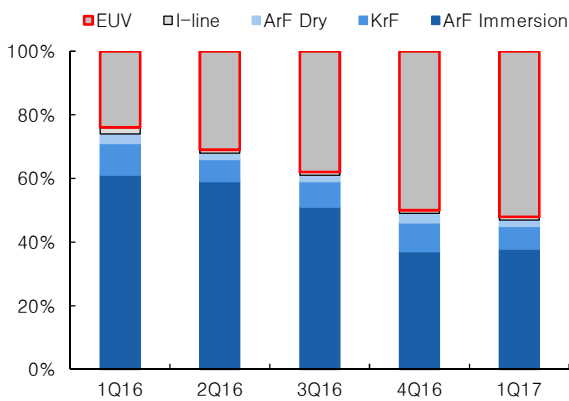
표 1. 1Q17 실적 요약

(백만유로, 유로, %)

	1Q17	4Q16	QoQ	1Q16	YoY
매출액	1,944	1,907.0	1.9	1,333	45.8
매출총이익	925	901.0	2.7	568	62.9
영업이익	535	530.0	0.9	228	134.6
순이익	452	524.0	-13.7	198	128.3
EPS (diluted)	1.05	1.22	-13.9	0.46	128.3
매출총이익률	47.6%	47.2%	0.3ppt	42.6%	5.0ppt
영업이익률	27.5%	27.8%	-0.3ppt	17.1%	10.4ppt
순이익률	23.3%	27.5%	-4.2ppt	14.9%	8.4ppt

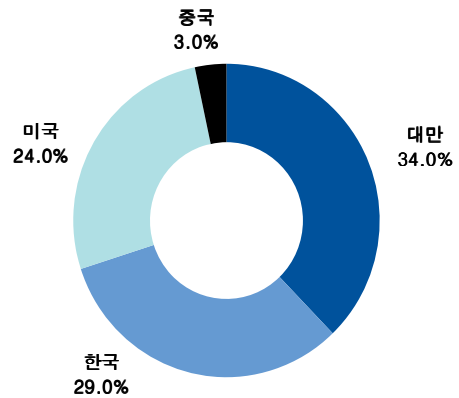
자료: ASML, 미래에셋대우 리서치센터

그림 1. 장비유형별 Backlog 트렌드



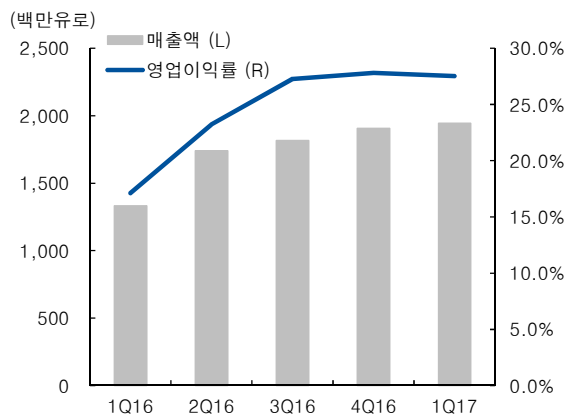
자료: ASML, 미래에셋대우 리서치센터

그림 2. 지역별 Backlog 비중 (1Q17)



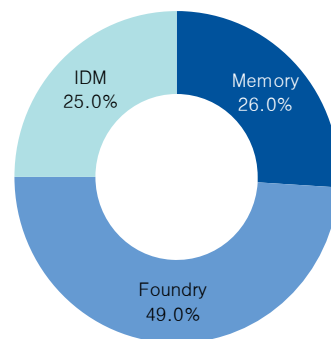
자료: ASML, 미래에셋대우 리서치센터

그림 3. 매출액 및 영업이익률 트렌드



자료: ASML, 미래에셋대우 리서치센터

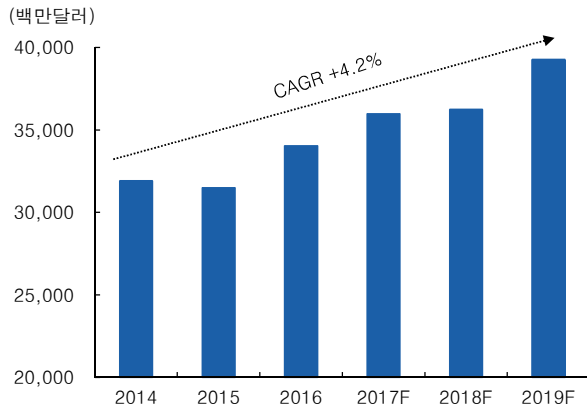
그림 4. 전방 업체별 Backlog 비중 (1Q17)



자료: ASML, 미래에셋대우 리서치센터

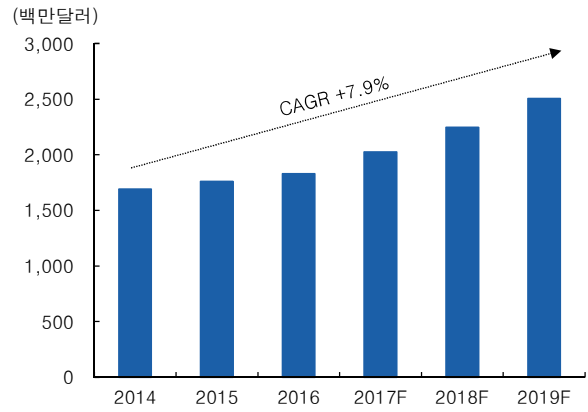
반도체 장비 시장 데이터

그림 5. 글로벌 반도체 장비 시장 규모 추이



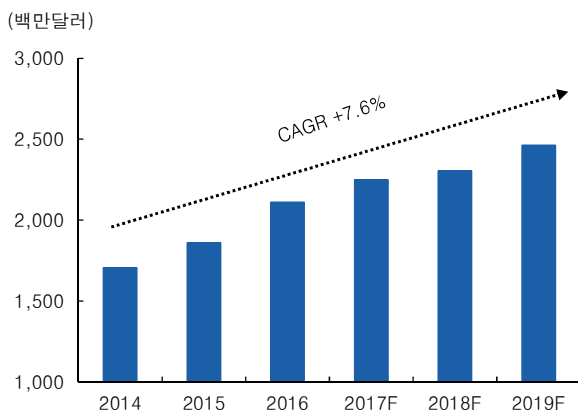
자료: Gartner, 미래에셋대우 리서치센터

그림 6. 글로벌 반도체 패키징 시장 규모 추이



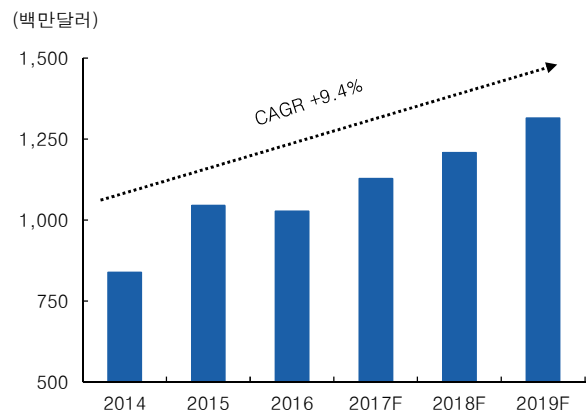
자료: Gartner, 미래에셋대우 리서치센터

그림 7. PECVD 장비 시장 규모 추이



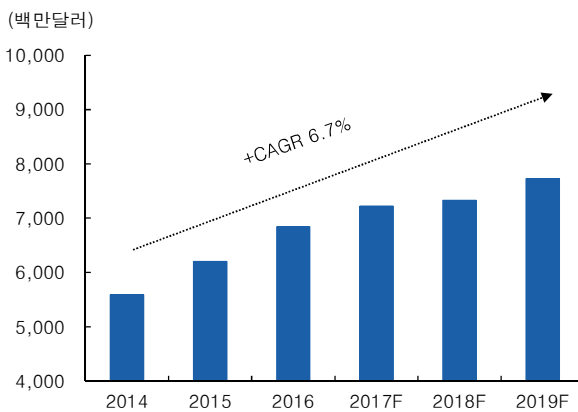
자료: Gartner, 미래에셋대우 리서치센터

그림 8. ALD 장비 시장 규모 추이



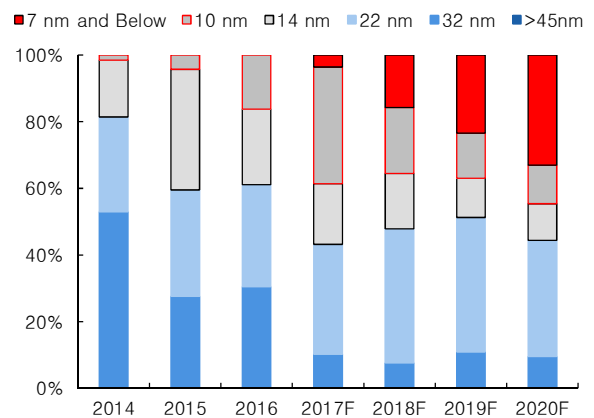
자료: Gartner, 미래에셋대우 리서치센터

그림 9. Dry Etch 장비 시장 규모 추이



자료: Gartner, 미래에셋대우 리서치센터

그림 10. 기술공정별 반도체 장비 시장 비중 추이



자료: Gartner, 미래에셋대우 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.